



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 半导体封装中的湿度可靠性、失效机制和建模

演讲人: 樊学军 教授 美国拉马尔大学

演讲摘要:

- 介绍
- 湿度引起的失效机制
 - 回流焊期间的故障 (Procon 测试)
 - 高加速温湿度试验的失败
 - 腐蚀 (温湿度偏压高加速应力测试)
- 案例研究 1: 选材工具
- 案例研究 2: 封装设计
- 水分扩散建模
- 总结

演讲人简介:

樊学军是德克萨斯州立大学系的董事教授,也是德克萨斯州博蒙特拉马尔大学的 Mary Ann 和 Lawrence E. Faust 的特聘教授。樊博士是 IEEE 院士,也是 IEEE 杰出讲师。他获得了 2017 年杰出持续技术贡献奖。2011 年获得 IEEE 电子封装协会颁发的杰出技术成就奖。樊博士是异构集成路线图建模与仿真委员会的联合主席。2004 年至 2007 年,樊博士在亚利桑那州钱德勒市的 Q&R 部门担任英特尔高级工程师。